

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2026-048

上海新阳半导体材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海新阳	股票代码	300236
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨靖	张培培	
电话	021-57850066	021-57850066	
办公地址	上海市松江区思贤路 3600 号	上海市松江区思贤路 3600 号	
电子信箱	info@sinyang.com.cn	info@sinyang.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,198,578,622.96	896,649,671.91	33.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,229,671.50	133,305,329.34	59.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	204,847,893.73	127,033,676.15	61.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,233,949.28	112,793,253.82	65.11%

基本每股收益（元/股）	0.6823	0.4280	59.42%
稀释每股收益（元/股）	0.6823	0.4280	59.42%
加权平均净资产收益率	4.05%	2.97%	1.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,906,555,202.97	6,958,803,297.00	27.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,828,725,438.83	5,153,696,324.76	32.50%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,807		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王福祥	境内自然人	14.37%	45,032,070.00	33,774,052.00	不适用	0.00
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	12.10%	37,933,276.00	0.00	不适用	0.00
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	6.63%	20,788,086.00	0.00	不适用	7,710,000.00
孙慧明	境内自然人	3.67%	11,509,999.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一三组合	其他	2.94%	9,208,709.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.71%	8,508,147.00	0.00	不适用	0.00
金叶飞	境内自然人	2.19%	6,865,504.00	0.00	不适用	0.00
SIN YANG INDUSTRIES&TRADING PTE LTD	境外法人	1.66%	5,216,294.00	0.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体	其他	1.33%	4,169,224.00	0.00	不适用	0.00

材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金						
杨燕灵	境内自然人	1.29%	4,046,900.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王福祥、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联股东，属于一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海新晖通过普通证券账户持有 31433276 股，通过信用交易担保证券账户持有 6500000 股，实际合计持有 37933276 股。孙慧明通过普通证券账户持有 1600000 股，通过信用交易担保证券账户持有 9909999 股，实际合计持有 11509999 股。金叶飞通过普通证券账户持有 100 股，通过信用交易担保证券账户持有 6865404 股，实际合计持有 6865504 股。杨燕灵通过普通证券账户持有 47000 股，通过信用交易担保证券账户持有 3999900 股，实际合计持有 4046900 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入 11.99 亿元，较去年同期增长 33.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.13 亿元，同比增长 59.96%，扣除非经常性损益后净利润为 2.05 亿元，同比增长 61.25%。公司半导体行业实现营业收入 10.11 亿元，同比增长 42.61%。依托深

厚的技术壁垒与持续迭代的产品研发能力，公司集成电路制造用关键工艺材料产品矩阵持续丰富，新品开拓顺利，下游客户订单持续增长。报告期内，公司晶圆制造用关键工艺材料营业收入整体实现大幅增长：晶圆制造用电镀液及添加剂系列产品市场份额稳步提升，集成电路制造用清洗、蚀刻系列产品在客户端拓展效果显著，蚀刻液系列产品增幅领跑，终端客户覆盖广度持续提升，拉动该产品销售规模快速增长。涂料板块业务，2026 上半年实现营业收入 1.88 亿元，同比基本持平，受行业景气度及内卷困局影响，净利润同比小幅下滑。

1、聚力科研攻关，厚植技术创新

公司坚定不移地贯彻执行以技术为主导的发展战略，始终坚持自主研发，持续创新；始终坚持面向产业需求，面向前沿技术，面向国内空白，面向进口替代的战略定位。报告期内，随着产业的快速发展以及与客户协同的逐步加深，围绕客户新材料、新工艺的迫切需求，公司在五大核心技术领域持续加大研发投入，创新产品技术，满足客户“材料+工艺参数+设备适配”的一体化方案需求，已实现从“集成电路关键工艺材料行业跟跑者变成局部领跑者”，公司在集成电路制造用关键工艺材料领域的竞争力不断提升。报告期内公司半导体业务研发投入总额 1.55 亿元，较上年同期增加 33.86%，占本期营业收入的比重为 15.32%，主要集中于集成电路制造用光刻胶、先进制程蚀刻液、清洗液、添加剂、化学机械研磨液等项目开发。

在当前的高性能计算（HPC）和 AI 训练场景下，TSV 被广泛视为先进封装和异构集成中最具前景的互连解决方案之一。经过多年的开发创新与技术储备，公司研发并量产的适用于 TSV 工艺的铜互连电镀添加剂，已经实现 3D-TSV 中微孔高效电镀填充，深宽比可达 20:1，且电镀均匀性、可靠性良好。公司电镀系列材料已广泛应用于先进封装工艺制程，为客户提供良好的技术保证。公司电镀系列产品的市场影响力从传统封装、晶圆制造延伸

至先进存储领域。报告期内，公司电镀液及添加剂系列产品销售额同比增长超 30%。随着先进封装工艺技术的应用扩大，公司与客户共同研发进行技术迭代，公司电镀液及其添加剂相关产品销售规模也将持续扩大。

在集成电路制造用清洗液产品方面，公司干法刻蚀后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖，广泛应用于逻辑电路、模拟电路、存储器件等晶圆制造客户。报告期内干法刻蚀后清洗液产品销售规模不断扩大，销售额快速增加，同比增长近 40%。与此同时，公司根据市场需求，持续推进高深宽比清洗液技术开发迭代，持续巩固公司晶圆清洗系列产品市场地位。

公司原创开发的用于芯片制造的蚀刻液产品，已实现四代技术产品的开发及迭代升级，可满足最大纵深比 1:200 的复杂图形的高精度蚀刻，达到蚀刻后图形的均匀性和平整性要求。目前公司已有三代技术产品实现规模化市场销售，开发出的适用于全世界最高水准的 3D NAND 存储芯片的高选择比氮化硅蚀刻液，选择性蚀刻速率最高可达 2000:1。报告期内公司各系列蚀刻液市场应用规模进一步扩大，较上年同期增长超 70%。针对半导体产业快速更新迭代的需求，公司研发团队持续纵深开发，做好前瞻性的材料研究和技术储备，针对 3D NAND、DRAM 存储工艺需求的蚀刻类配方型化学品技术重点开发，助力国产下一代存储芯片持续领先。

公司致力于推动高端光刻胶及配套产品国产化进程，已建成包括 I 线、KrF、ArF 干法、ArF 浸没式各类高端光刻胶完整的研发合成、配制生产、质量管控、分析测试平台，全面承接国内主流晶圆制造企业国产替代项目，部分品类产品已实现产业化导入。报告期内，公司形成批量稳定供货的光刻胶数量快速提升，整体销售规模较上年同期增长 27%。

公司化学机械研磨液产品持续优化，产品存放稳定性和表面粗糙度指标稳步提升，STI slurry、Poly slurry、W slurry、Oxide slurry 等系列产品在头部客户端测试验证顺利，

其中，先进制程 STI slurry、Poly slurry 产品已进入国内主流晶圆公司产线，产品性能优越，打破了国外对该产品的垄断，多客户、多制程的平台化供货格局为研磨液产品未来发展奠定基础。报告期内研磨液产品销售额较上年同期增长 140%。

2、扩容产能布局，筑牢发展根基

面对行业需求的快速提升，公司持续聚焦“业务规模做大、技术能力做强、行业地位做高，成为半导体材料行业引领者”的发展战略。报告期内，公司布局建设的集成电路制造用关键工艺材料产品仍然面临旺盛的市场需求。

为了进一步巩固公司在国内半导体材料行业的领先地位，公司结合市场需求变化情况及整体发展规划，增加合肥新阳材料产能，报告期内，部分电镀液、蚀刻液、清洗液扩产产线及研磨液产线均已实现顺利投产。同时，公司积极布局推进上海化学工业区项目建设。此外，上海松江本部 128 亩年产 50000 吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目，部分厂房、仓库已结构性封顶，目前进展顺利。伴随公司半导体板块产能布局持续深化、新建产能相继落地投产，产能规模有序释放，可充分承接市场增量需求，为企业中长期战略规划稳步落地筑牢产能支撑。

3、精进内部运营，激发内生动力

2026 年公司持续深化“半导体气息”建设，依托知识问答、例行检查、季度宣贯强化全员相关意识，将“专业、认真、务实、执行力”的工作作风落到实处，增强企业发展韧性与行业影响力。公司持续优化运营管理体系，稳步提升市场规划、供应链、质量、安全生产等领域运营效率，常态化开展信息安全管理，保障数据资产安全、助力业财融合转型。此外，新阳 AI 材料科学家平台完成 2.0 版本迭代，支撑材料分析和研发判断，赋能公司材料创新研发，护航企业高质量发展。

面对业务扩容、技术攻关难度加大的发展现状，公司深耕人才体系建设。结合行业趋势与自身战略布局，打造高水平管理与技术开发两支核心队伍，通过行业专题讲座、师徒带教夯实基础培养；配套落实员工轮岗历练、职级序列常态化评定，专项搭建后备人才梯队、重点培育多技能复合型人才，完善分层级人才梯队架构，为员工搭建多元成长晋升平台，实现员工与企业协同发展、共同进阶。

人文关怀维度，公司以“心温暖”为主线，全方位守护员工工作与生活：公司官方网站正式焕新上线，内部宣传平台顺利投用，加速公司品牌建设；通过民主对话会常态化收集员工意见，持续优化员工办公环境，在固定节日举办对应主题节日活动并派送节日礼品，开展“启航芯长征，决胜新三年”活动丰富员工职业生活，充分激发员工工作热情与生活活力，稳步提升员工企业文化认同感、团队归属感。

2026 年公司稳步落地股权激励相关工作，深耕薪酬证券化长效激励机制建设：有序办结存量 6 期股权激励解锁、归属工作，紧密绑定核心人才；顺利推出新成长（四期）股权激励计划与 2026 年股票增值权激励计划，让员工共享企业经营发展成果，切实提升在岗员工幸福感与归属感。后续公司将坚持长效激励导向，持续吸纳集聚优质人才，为企业长期稳定发展筑牢人才保障。

4、产业协同赋能，产教融合发展

公司在稳健推进自身高质量发展、持续突破技术壁垒的同时，主动践行企业担当与行业责任，积极参与产业共建、科普推广与行业交流，助力国内半导体产业生态持续完善。公司积极参与各类行业展会、产业峰会及行业协会交流活动，常态化开展技术研讨与经验共享，主动输出半导体材料研发成果与产业化实践经验，推动行业技术互通、资源共建共享，为企业战略布局优化提供有力的行业信息支撑。同时，公司积极履行社会责任，联合

松江经开区开展多场半导体产业宣讲与科普活动，普及产业知识、传播前沿发展理念，助力培育良好的产业发展氛围。

公司始终深耕产学研深度融合发展路径，持续搭建校企协同创新平台，激活产业创新与人才培育动能。公司与国内多所高校、科研院所开展产学研合作项目，互动走访交流，打造前沿科技协同创新载体。公司与各方围绕集成电路关键材料研发、技术成果转化、校企人才联合培养等议题深入研讨，精准对接校企优质资源、互补优势，持续夯实产业人才根基，为行业长效创新发展注入强劲活力。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2026 年 8 月 19 日